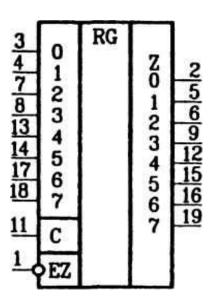
## КР1533ИР22, КФ1533ИР22, ЭКР1533ИР22, ЭКФ1533ИР22

Микросхемы представляют собой восьмиразрядный регистр на триггерах с защелкой с тремя состояниями на выходе и предназначены для управления большой емкостной или низкоомной нагрузками. Корпус типа 2140.20-8, масса не более 2,6 г и 2140.20-В.

Назначение выводов: 1 - вход разрешения снятия состояния высокого импеданса  $\overline{EZ}$ ; 2 - выход Q0; 3 - вход информационный D0; 4 - вход информационный D1; 5 - выход Q1; 6 - выход Q2; 7 - вход информационный D2; 8 - вход информационный D3; 9 - выход Q3; 10 - общий; 11 - вход тактовый C; 12 - выход Q4; 13 - вход информационный D4; 14 - вход информационный D5; 15 - выход Q5; 16 - выход Q6; 17 - вход информационный D6; 18 - вход информационный D7; 19 - выход Q7; 20 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИР22

## Таблица истинности

Вход			Выход
$\overline{EZ}$	С	D	О
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	X	Q0
1	Χ	Χ	Z

## Электрические параметры

10				
- при I <sup>0</sup> <sub>вых</sub> = 12 мА				
- при I <sup>0</sup> <sub>вых</sub> = 24 мА	≤ 0,5 B			
Выходное напряжение высокого уровня:				
- при I <sup>1</sup> <sub>вых</sub> = -2,6 мА	≥ 2,4 B			
- при I <sup>1</sup> <sub>вых</sub> = -0,4 мА	≥ 2,5 B			
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде≤  -1,5  В				
Ток потребления при низком уровне выходного				
напряжения при U <sub>п</sub> = 5,5 В	≤ 25 mA			
Ток потребления при высоком уровне выходного				
напряжения при U <sub>п</sub> = 5,5 В	≤ 16 MA			
Ток потребления в состоянии «выключено»				
при U <sub>п</sub> = 5,5 В; U <sub>вых</sub> = 2,7 В	≤ 27 mA			
Входной ток низкого уровня	≤  -0,1  mA			
Входной ток высокого уровня				
Входной пробивной ток				
Выходной ток				
Выходной ток высокого уровня в состоянии	1 1 1 1			
«выключено»	≤ 20 мкА			
Выходной ток низкого уровня в состоянии				
«выключено»	≤  -20  мкА			
Время задержки распространения сигнала при включении				
- по входу D				
-   по входу С				
Время задержки распространения сигнала при выключени				
- по входу D				
- по входу C				
Время задержки распространения сигнала при переходе	2 ZZ NC			
из состояния «выключено» в состояние высокого уровня	< 20 µc			
Время задержки распространения сигнала при переходе	20 HC			
из состояния высокого уровня в состояние «выключено».	< 10 HC			
Время задержки распространения сигнала при переходе	2 40 HC			
из состояния «выключено» в состояние низкого уровня	< 18 uc			
	2 10 HC			
Время задержки распространения сигнала при переходе	< 20 116			
из состояния низкого уровня в состояние «выключено»				
Емкость входа				
Емкость выхода	≥ / ΠΨ			
Предельно допустимые режимы эксплуатации				
Напряжение питания	45 55R			
Входное напряжение низкого уровня				
Входное напряжение низкого уровня	UU,O D			

Входное напряжение высокого уровня ......2....2...5,5 В

Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 B
Температура окружающей среды	10+70 °C

## Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °C; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °C; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше  $60\,^{\circ}\text{C}$ .

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака  $65 \pm 5$  °C. Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного

напряжения  $5 \ B \pm 10\%$ , к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.